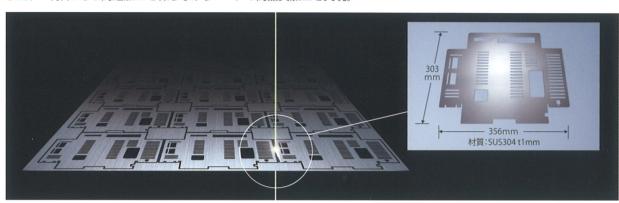
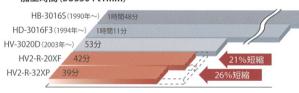
### 薄板高速切断

高速加工、50m/min(Z軸65m/min)の高速早送り他、最新制御技術により生産性が飛躍的に向上。 また、DR制御により高速加工を保ちながらコーナの高品質加工を実現。



### ■ 上図のワークサンプルを21個加工した場合の比較

### 加工時間(SUS304 t1mm)



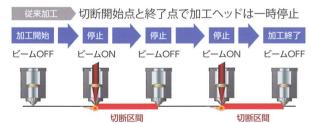
### ランニングコスト(SUS304 t1mm)



### ▼ 薄板高速切断を支えるテクノロジー

### F-CUT機能

発振器と制御装置の高速通信により、軸停止なくビームオン・オフを制御、加工時間を短縮。



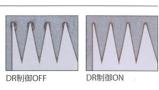
### Z軸高速化

最新制御技術の採用に加え、Z軸の 移動速度約2倍、加速度約5倍(従 来機HVシリーズ比)により、加工時間を短縮。



### DR制御(ドロスリダクション制御)

従来は高速でコーナを加工すると付着したドロスをDR制御により低減。高速・高品位加工を実現。

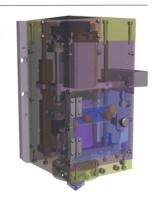




### 新型自動プリセットヘッド(PH-XS)

NC指令によりレンズ焦点位置を自動的に制御。加エレンズの駆動速度を最大約5倍※に向上させ、ピアシング時間や加工時間を短縮。

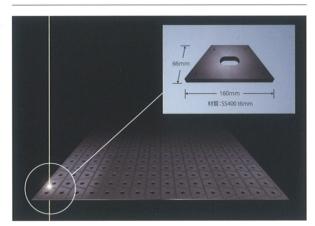
※従来機HVシリーズ比



### 軟鋼切断

小径ノズルによる高速切断技術の向上と最新ピアシング技術の搭載により従来機と比較し生産性、ランニングコストを大幅削減。

### 軟鋼中厚板切断

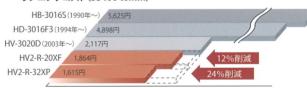


### ■上図のワークサンプルを316個加工した場合の比較

### 加工時間(SS400 t6mm)



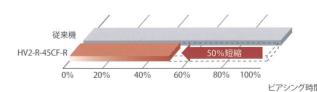
#### ランニングコスト(SS400 t6mm)



### ▼ 軟鋼中厚板高速切断を支えるテクノロジー

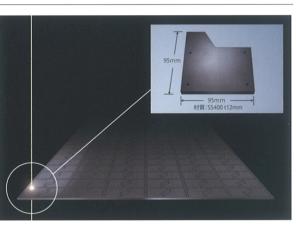
### ビートピアス

高ピーク出力制御により、従来のスロープピアス同等の品質を実現しながら、軟鋼t9mm~t25mmのピアシング時間を従来機比最大50%短縮。



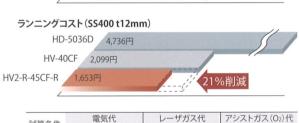
加工対象:SS400 t25mm 従来ピアシング時間を100とした場合の時間比率

### 軟鋼厚板切断



■上図のワークサンプルを128個加工した場合の比較





計算な/	電気代	レーザガス代	アシストガス(O2)代
試算条件 一	20円/kwh	8.94円/ℓ	0.13円/ℓ

### FAB制御

三菱独自のビーム特性安定化技術・FAB制御は、加工中のビームを常時コントロール。加工に最適なビーム特性を常に維持することにより、長期的なシステムの安定稼働を支援。

# FAB RICATION MITSUBISHI original "control"

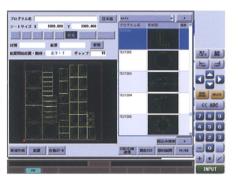
\*カタログ記載データは参考値であり、実際とは異なる場合があります。

### より確かに、快適な操作を極めていく

### ▼ さらなる操作性の向上

### 簡易ネスティング

急な加工枚数の追加があった場合でも簡易ネスティング機 能により加工機でネスティングプログラムを作成できます。

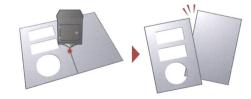


### 残材切断

加工後の残材を画面からの操作で簡単に切り分け可能。



残材切断画面



### マグネット式ダメージ軽減機能(オプション)

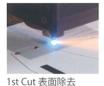
万一の加工ヘッド衝突時にも、芯出し調整がいらず復旧時間 を大幅に削減した、安心の機構です。





### 2度切り機能

通常切断では加工不良が発生しやすい粗悪材料や保護シー ト付材料を2度切り機能により高品位に加工可能。







加工ヘルプ画面

特殊材料参考条件、条件修正方法、加工ノウハウをNCにより 充実サポート。



加工したい特殊材料 を選択すると、参考条 件・加工ヘルプを参 照できます。



No Mannan-Nuns

### バーコード読み出し(オプション)

バーコードリーダで加工指示書などに印字されたバーコード を読み取ると、自動でNCプログラムを運転サーチし、描画 チェックを行うことができます。

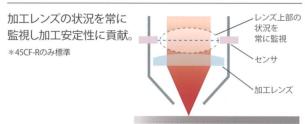


### 作業ヘルプ画面

各機器の主な作業について、写真および図付きで解説。 例:真空ポンプオイルの交換の場合



### 加工レンズ監視機能



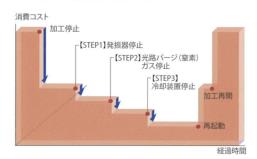
### ecoモード

加工操作完了後、各装置を自動で段階的に停止。 【STEP1】発振器停止▶

【STEP2】光路パージガス停止▶ 【STEP3】冷却装置停止

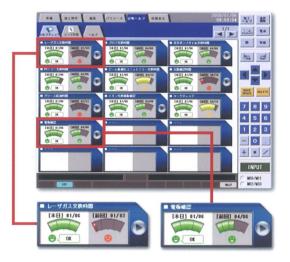
これにより、待機時の消費コストを最大99%削減。また、加工再 開時は復帰ボタンにより、1~3分間\*で加工再開が可能。

※各STEP・使用環境により復帰時間は異なります。



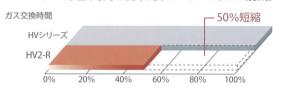
### セルフチェック機能

主要部品について定期的にチェックし、診断結果を通知。 連続稼働をサポート。



### レーザガス交換

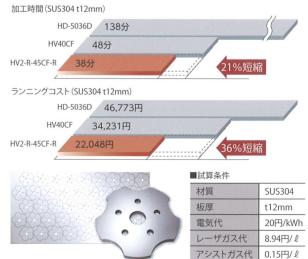
レーザガスの交換時間を従来比(HVシリーズ)50%削減。



### 加工ガス消費量低減(eco条件)

レーザアシストガス条件の最適制御技術により、窒素ガス消費 量を大幅削減。

■下図のワークサンプルを45個加工した場合の比較



# Multi processing

加工性能

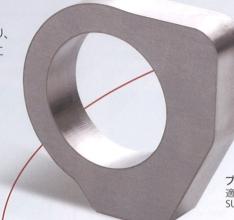
# より自在に、加工の可能性を広げていく

### ブリリアントカット

CF-Rシリーズの高いビームクオリティにより、 ステンレスの無酸化切断において機械加工 普通仕上げ(▽▽:Rz25 μ m以下) 相当の切断面粗さを実現。

加工機	発振器	最大適用板厚	
HV2-Rシリーズ	ML45CF-R	12mm (*1)	

\*1: f254mm(f10")レンズ使用時(オプション)



ブリリアントカット

ブリリアントカットサンプル 適用発振器:45CF-R SUS304 t12mm

### パイプ加工

ターンテーブル(オプション)により、 多種多様な形状が加工可能。

Z軸ストローク300mmを 活かした加工



パイプ加工サンプル 適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R ステンレスt2mm、鋼管 t6mm.など

### 箱モノ追加工

Z軸の長ストロークを活かして 箱モノへの追加工が容易に可能。



適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R 軟鋼t2mm

### **複合加工**

パンチプレスで加工された 基準穴を基に高精度に位置決め、 レーザとパンチプレスの 複合加工を実現



複合加工サンプル 適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R SECC t1.2mm

### 極薄加工

高品質のシングルモードビーム により、1mm未満の 極薄板の高品質加工を実現



極薄板サンプル 適用発振器: 13XF ステンレスバネ材t0.1mm



極薄板サンプル 適用発振器: 13XF リン青銅 t0.2mm

## 厚板加工





A1100 t8mm

特殊金属サンプル

TANAAA

適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R

ステンレスサンプル 適用発振器:45CF-R

SUS304 t16mm

### 多種多様な加工

アルミサンプル 適用発振器:45CF-R

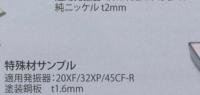
**樹脂加工サンプル** 適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R

### 特殊金属、塗装鋼板、樹脂など の加工条件、加工ノウハウを搭 載、多種多様な加工を実現。

特殊材加工



特殊金属サンプル





MEL業LASER 特殊金属サンプル

適用発振器: 20XF/32XP/45CF-R クロムモリブデン鋼 t12mm

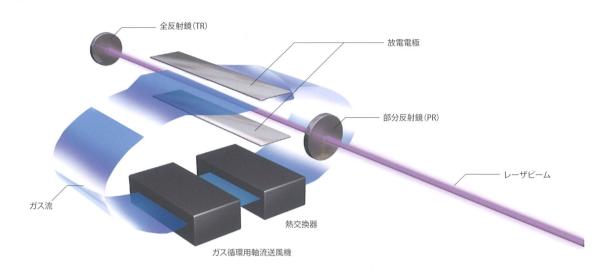
\*上記は特定の条件の元での加工能力であり、検収条件は仕様書によります。\*被加工物は同一規格品であっても、表面状態や含有成分により加工性能・品質に差異を生ずる場合が あります。\*加工形状により加工性能・品質に差異を生ずる場合があります。\*軟鋼(SS400)については、中部鋼鈑(株)製LS材(レーザ切断用鋼板)使用時の能力を記載しております。

# Oscillator SD励起三軸直交形発振器



### ▼ 高信頼加工を支えるのは、独自のテクノロジー

三菱独自のテクノロジーが、高信頼を実現。さらなる加工性・安定性の向上を実現した、三菱の発振器シリーズ。



高速パワーセンサ

当社独自の「高速パワーセンサ」を標準搭載することにより、 レーザ出力をリアルタイムに監視。設定出力を忠実に再現 し、出力安定度は±1%以下。アルミ、銅など高反射材の連続 加工も可能。



レーザガス封じ切り運転

ガス封じ切り運転は混合ガスを流し捨てず、ガスボンベは年間1本程度で済みます(ML20XFで年間2400hr運転の場合)。また、当社発振器で使用するレーザガスはヘリウムガスの組成比が他社と比べて少なく、希少ガスへの依存度が低いことが特長です。

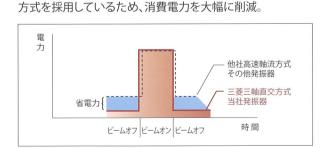
ジャストオンタイム放電方式

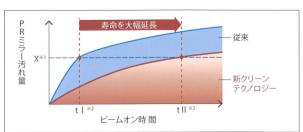
ビームオフ時の消費電力が少ないジャストオンタイム放電

### 軸流形レーザ 発振器 三菱炭酸ガス レーザ発振器 (ML20XF) 0 200 400 600円/hr \*比較はSPCC t1.2mm加工時、稼働率50%の場合です。 (発振器のみで加工機は含みません)

新クリーン技術による光学部品の長寿命化

クリーンテクノロジーのさらなる改良により発振器PRミラー寿命の大幅延長が可能となりました。※対象機種:ML45CF-R



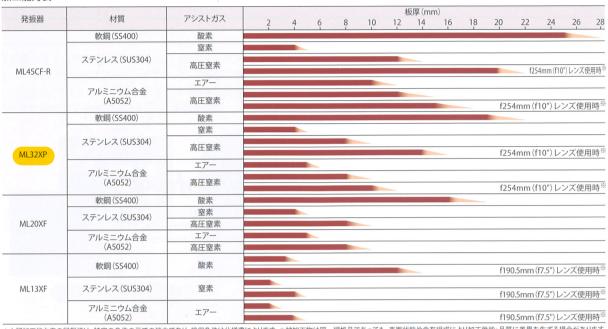


※1:PRミラー汚れの限界値Xは加工内容、要求仕様などにより異なります。
※2:PRミラー汚れの限界値に到達する時間t | 、t || は発振器内部品の劣化状況などにより異なります。

# Specification dt標



### 加工能力表



<sup>\*</sup>上記加工能力表の記載値は、特定の条件の元での能力であり、検収条件は仕様輩によります。\*\*被加工物は同一規格品であっても、表面状態や含有組成により加工性能・品質に差異を生ずる場合があります。
\*\*加工形状により加工性能・品質に差異を生ずる場合があります。\*\*軟鋼(SS400) t19mm以上の板厚については、中部鋼鈑(株) 製LS材(レーザ切断用鋼板)使用時の能力を記載しております。\*\*はオブション。

### 加工機仕様

形名				ML1212HV2-R	ML2512HV2-R	ML3015HV2-R	
移動方式				ハイブリッド方式(X軸:テーブル移動、Y軸:光移動)			
制御方式				X-Y-Z同時3軸(Z軸倣い制御も可能)			
	対象ワーク寸法(mm)		1,220×1,220	2,440×1,220	3,050×1,525		
オース	ワーク	ワーク支持高さ(mm)		850			
			X軸(mm)	1,250	2,500	3,100	
	ストロ-	ーク	Y軸(mm)	1,250	1,250	1,550	
			Z軸(mm)	300			
		早送り速度	XY軸(m/min)	最大50			
	速度		Z軸 (m/min)	最大65			
		最大加工送り速度	₹(m/min)	30			
		(4 m) + 1 / 4 m	XY軸(mm)		0.01/500		
	精度	位置決め精度	Z軸(mm)		0.1/100		
		繰り返し精度(mn	n)		±0.005		
	加工ヘッド			自動焦点プリセット加工ヘッド PH-XS			
適合発振器		ML13XF、ML20XF、ML32XP、ML45CF-R					
電源入力(加工機単体)(kVA)				6	6	6	
質量(加工機単体)(kg)			1270	約6,600	約7,600	約9,600	

### 発振器仕様

形名 励起方式		ML13XF	ML20XF	ML32XP	ML45CF-R		
		The state of the s	SD励起三軸直交形				
	パルスピーク出力(W)	2,500	3,000	3,200	5,000		
	定格出力(W)	1,300	2,000	2,700	4,500		
レーザ出力特性	ビームモード	シングル (TEM00主成分) 低次 (TEM01*主成分)					
	出力安定度(%)	土1以下 出力制御時(対定格出力)					
	出力可変範囲(%)		0~100				
レーザガス組成			CO <sub>2</sub> :CO:N <sub>2</sub> :He = 8:4:60:28				
レーザガス消費量(ℓ/hr)			約1 約				
電源入力(発振器単体)(kVA)		27	33	41	69		
外形寸法(mm)			2,040×450×1,620				
質量(発振器単体)(kg)			約1,200				

### 冷却装置仕様

適合発振器		ML13XF	ML20XF	ML32XP	ML45CF-R
水冷式冷却装置	形名	LCU10WIX			LCU20WIX
	電源入力(冷却装置単体)(kVA)	18			32
	外形寸法(mm)	1,790×735×1,722			2,350×735×1,722
	質量(冷却装置単体)(kg)	約800			約1,000
空冷式 冷却装置	形名	LCU10AIX		LCU15AIX	LCU20AIX
	電源入力(冷却装置単体)(kVA)	20		21	40
	外形寸法(mm)	1,970×1,010×2,027		2,390×934×1,772	2,980×1,010×2,027
	質量(冷却装置単体)(kg)	約800		約850	約1,100

### 制御装置仕様

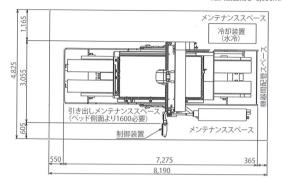
形名	LC30BV2		
CPU	64ビット		
表示装置	(タッチパネル式)15型TFT		
SSD ユーザ記憶容量(GB)	12		
プログラム入力方式	画面作成、USB(Ver2.0)、 イーサネット		
運転方式	メモリ運転、 HDダイレクト運転		

# Layout Daroth



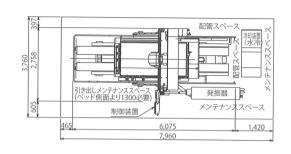
### ML3015HV2-R-13XF/20XF 水冷

(最大設置高さ:2,350mm)



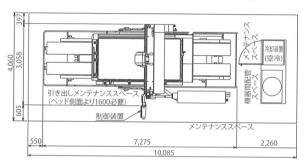
### ML2512HV2-R-13XF/20XF 水冷

(最大設置高さ:2,350mm)



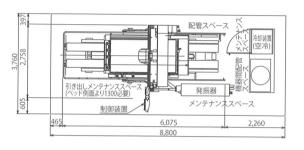
### ML3015HV2-R-32XP 空冷

(最大設置高さ:2,350mm)



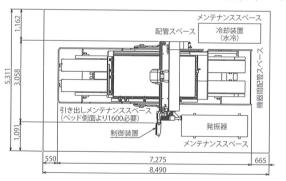
### ML2512HV2-R-32XP 空冷

(最大設置高さ:2,350mm)



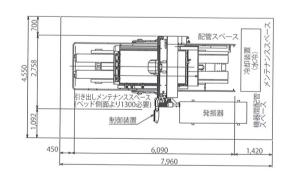
### ML3015HV2-R-45CF-R 水冷

(最大設置高さ:2,350mm)



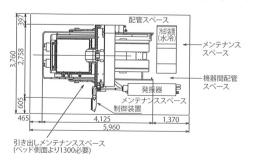
### ML2512HV2-R-45CF-R 水冷

(最大設置高さ:2,350mm)



### ML1212HV2-R-13XF/20XF 水冷

(最大設置高さ:2,350mm)



### ML2512HV2-R-13XF/20XF 空冷

(最大設置高さ:2,350mm)

